

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

扬州扬杰电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动	
参与单位名称及人员姓名	机构名称	姓名	机构名称
	宁泉资产	张斌	睿郡资产
	国泰基金	程洲	富国基金
	永赢基金	许拓	运舟资本
	红杉中国	闫慧辰	中颖投资
	景领投资	王胜	金百镕投资
	中信证券	叶达	中信证券
	泉果基金	姜菏泽	泉果基金
	泉果基金	王苏欣	华源证券
	华泰资产	刘旭文	天风证券
	汇丰晋信基金	刘昱辰	西部利得
	鹏华基金	陈锐	人保资产
	中泰电子	康丽侠	兴银基金
	盛钧投资	童胜	浙商基金
	国君资管	肖凯	淳厚资产
	盛宇投资	刘江炜	禀赋资本
	Fidelity International	杨旭	UBS
	UBS	李欣蕾	三井住友
时间	2026年1月21-30日		
地点	扬州扬杰电子科技股份有限公司会议室		
上市公司接待人员姓名	副董事长 梁瑶先生 副董事长 刘从宁先生		

	<p>董事会秘书 秦楠女士 证券投资部 陈逸妍</p>
<p>投资者关系 活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍及近期经营情况概述</p> <p>公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品主要分为三大板块，具体包括材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5吋、6吋、8吋硅基及6吋碳化硅等各类电力电子器件芯片）及封装器件板块（MOSFET、IGBT、SiC 系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列）。产品广泛应用于汽车电子、人工智能、清洁能源、5G 通讯、智能安防、工业、消费类电子等诸多领域，为客户提供一站式产品、技术、服务解决方案。公司 2025 年度经营情况良好，前三季度营业收入同比提升 20.89%，各下游领域如汽车、消费电子等呈良好发展态势，第四季度延续前三季度发展情况，经营态势稳中向好，毛利率保持相对稳健水平。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q: 请介绍一下越南工厂近期的进展情况。</p> <p>A: 公司越南 MCC 封测工厂当前运营态势良好，二期项目顺利通线后，快速实现产线运转，现阶段聚焦贴片、小信号产品布局，目前已满产满销，后续将持续推进产能扩张。同时，配套越南封测工厂的晶圆厂建设的前期筹备已全面开展，预计 2027 年正式投产，爬坡增长，项目落地后将进一步完善海外产业链布局，更好地满足市场对功率半导体产品的需求。</p> <p>Q: 请介绍一下公司后续的收并购计划和筛选收并购标的时关注的要素。</p> <p>A: 在确保主业发展的前提下，公司会以审慎的态度积极寻找优质并购标的，确保并购行为符合公司长期利益及全体股东权益。主要聚焦功率半导体主业本身，围绕产业链上下游优化资源配置。对此，公司主要关注两点：一是标的与公司在业务、技术等方面的优势互补性，实现能力互补，放大协同价值；二是标的的产能</p>

布局，通过并购补充优质产能、优化产能结构，支撑公司主业规模与持续发展，不断丰富公司的半导体产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

Q：请介绍公司对工业方面在 2026 年景气度的预期。

A：从需求端来看，制造业设备以旧换新相关补贴政策的落地实施，将为行业释放增量需求，为产业带来新的成长驱动力。加之前期“两新”政策布局已形成扎实积累，直接带动功率半导体下游应用需求扩容，多重利好预计会共同驱动工业板块景气度稳步攀升。以上，从工业领域设备升级、效能提升的需求持续释放来看，2026 年工业整体发展态势向好。

Q：公司 2026 年对汽车电子方面的展望。

A：公司汽车电子业务板块属于战略发展领域，未来将依托行业发展趋势及自身积累，实现持续、较快增长。这一增长目标的实现，得益于公司自 2017 年起前瞻性布局汽车电子专线所构建的体系能力、近年来通过多家国内外知名 Tier 1 厂商认证并已与主流终端厂商展开战略合作所打下的市场基础，以及汽车电动化、智能化转型所带来的持续行业机遇。基于现有基础，公司将持续加大汽车电子领域研发投入，同时依托越南生产基地推进海外车规体系搭建，结合 MCC 品牌在全球多国的布局优势，进一步开拓海内外汽车电子业务，持续强化全球化供应链服务能力，充分把握行业发展红利，持续推动业务规模化发展。

Q：请介绍公司 2026 年对消费方面的展望。

A：2026 年公司将在巩固现有市场份额的基础上，持续深化与优质客户的合作。从行业整体来看，前期家电领域补贴力度相对较大，当前补贴下降可能会对部分需求形成一定影响。但基于公司在市场的深耕布局和与优质客户的长期合作，且后

	<p>续市场将逐步推出各类新型应用，为行业带来明确增量空间，AI 服务器、低空经济、穿戴设备等市场需求正快速释放，行业发展潜力显著，公司会紧跟消费电子市场的产品创新趋势，以研发为核心驱动进行产品布局，预计 2026 年消费电子业务将实现平稳增长。</p> <p>Q: 请介绍公司未来的资本开支计划。</p> <p>A: 公司未来资本开支计划主要包括以下几个方面：一是越南工厂封装产线的持续投入和后续晶圆厂建设；二是八寸晶圆产线的扩产；三是碳化硅的持续投入；四是汽车业务相关产线的扩产；五是先进封装项目的建设等。</p> <p>Q: 请介绍公司在新兴领域业务方面的规划。</p> <p>A: 公司目前已围绕无人机等低空经济、储能、人形机器人、AI 服务器等新兴领域业务已成立专项小组，加大研发投入和技术布局，聚焦适配下游需求的功率半导体产品研发，培育新的业绩增长极。目前相关业务营收占比尚小，但行业景气度高，未来将实现快速增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 2 月 3 日